

# 図研エルミック株式会社 会社説明会

---

(東証マザーズ：4770)

2013年5月28日

代表取締役社長 朝倉 尉

# 2013年 3月期 決算報告

---

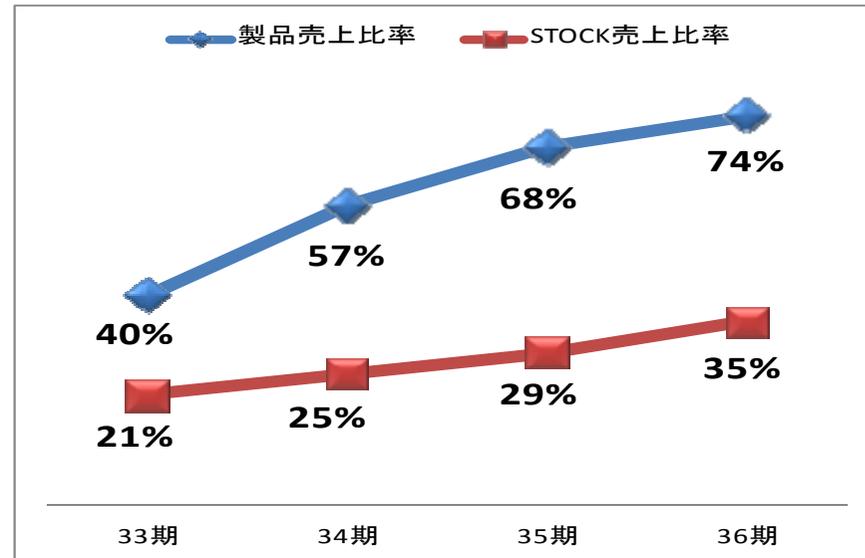
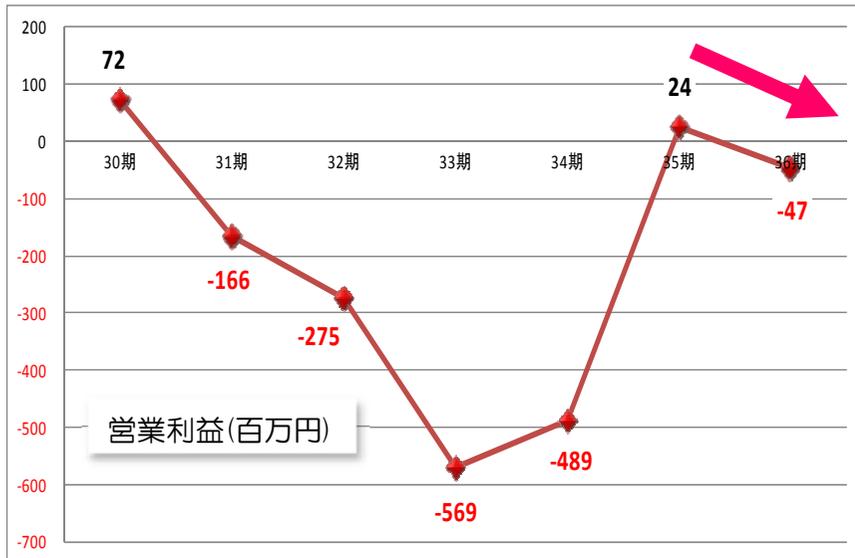
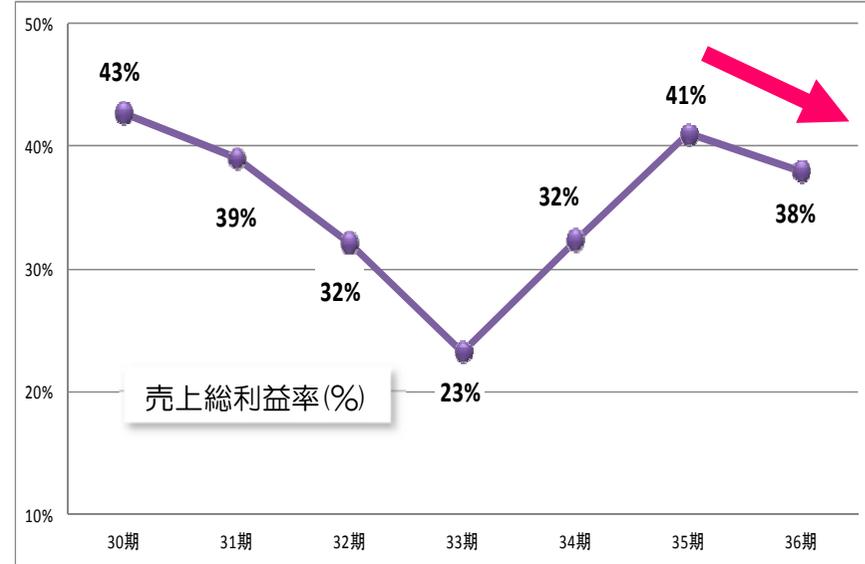
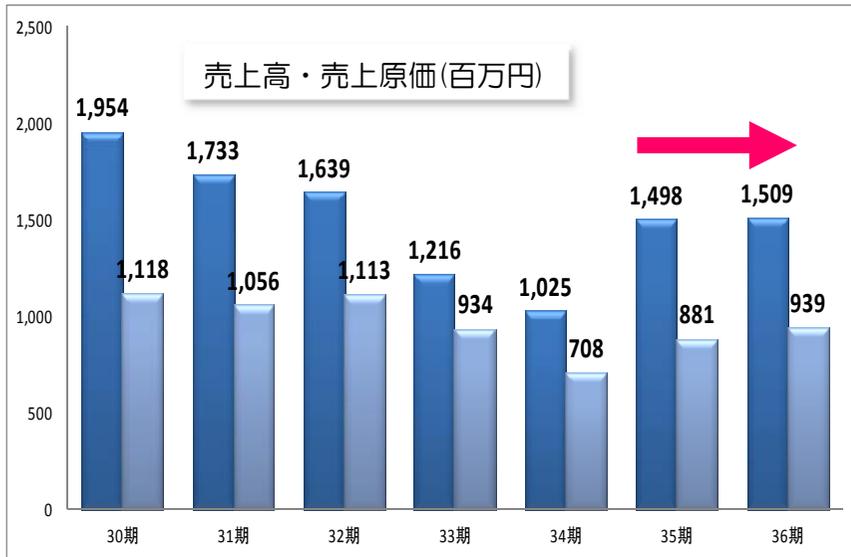
# 業績結果



第36期 単位：百万円, %	上半期		第3四半期		第4四半期		下半期		通期	
	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比	実績	前年同期比
売上高	688	103%	320	121%	501	88%	821	99%	1,509	101%
売上原価	403	101%	195	114%	340	109%	536	111%	939	106%
売上総利益	284	106%	124	132%	160	63%	285	81%	569	92%
販管費	319	109%	155	99%	142	98%	298	99%	617	104%
営業利益	▲35	▲11	▲31	+31	18	▲92	▲12	▲61	▲47	▲72
経常利益	▲34	▲13	▲31	+26	19	▲93	▲11	▲67	▲46	▲80
当期純利益	▲33	▲10	▲32	+26	▲58	▲87	▲90	▲60	▲123	▲71

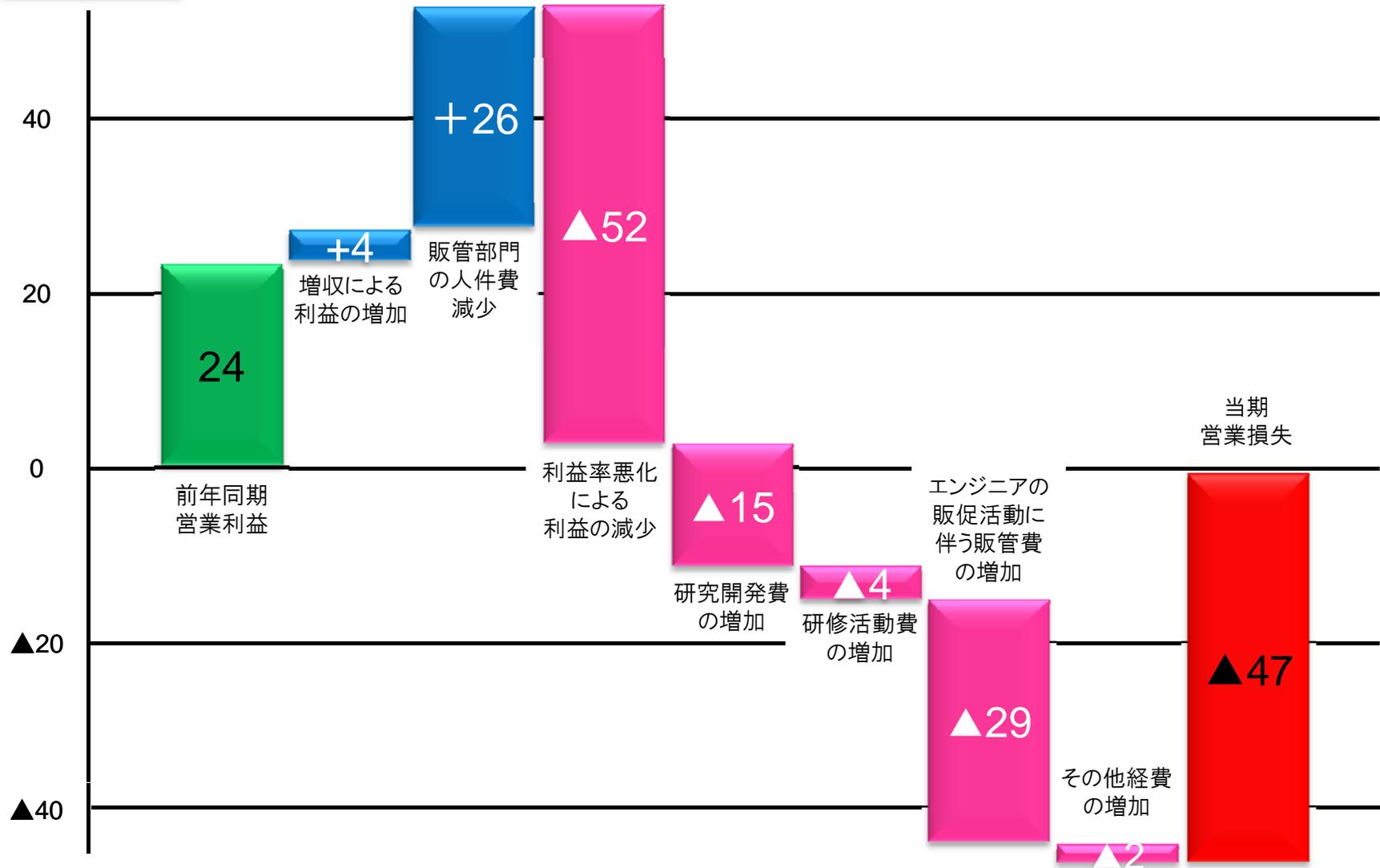
- 営業損益、経常損益、純損益の各指標において、赤字計上。
  - ミドルウェア製品事業の一部開発業務における大幅な遅延に伴い、原価の大幅増加。
  - ハードウェア製品事業における一部不採算事業撤退に伴い、売上高増加が鈍化。
  - FA製品事業における大口顧客の需要低下に伴い、エンジニア空き工数増加、販管費増加。
- 損害賠償訴訟の和解に伴い、和解金等の引当による特別損失計上(約72百万円)。

# 業績推移

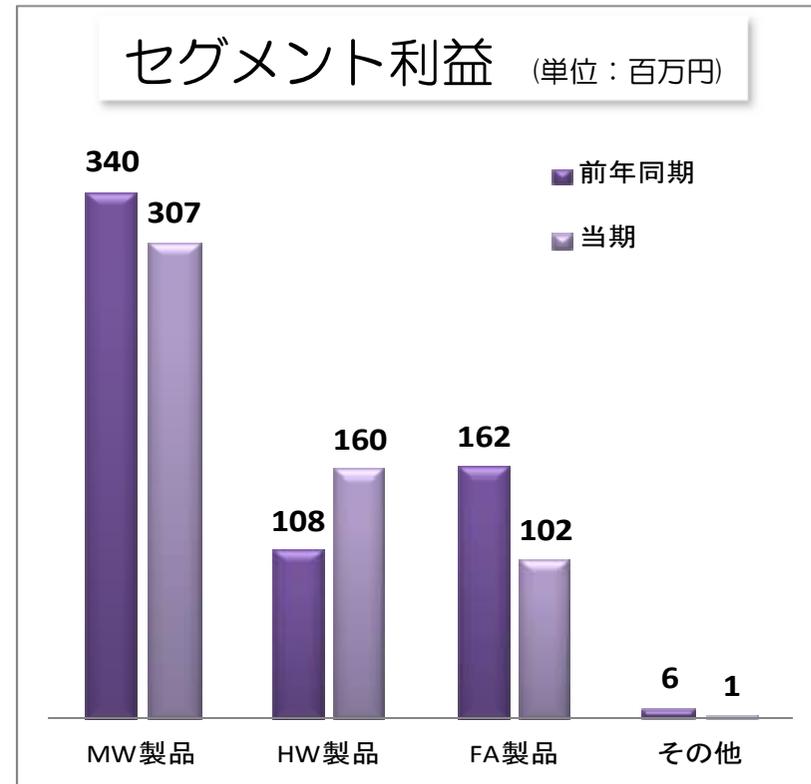
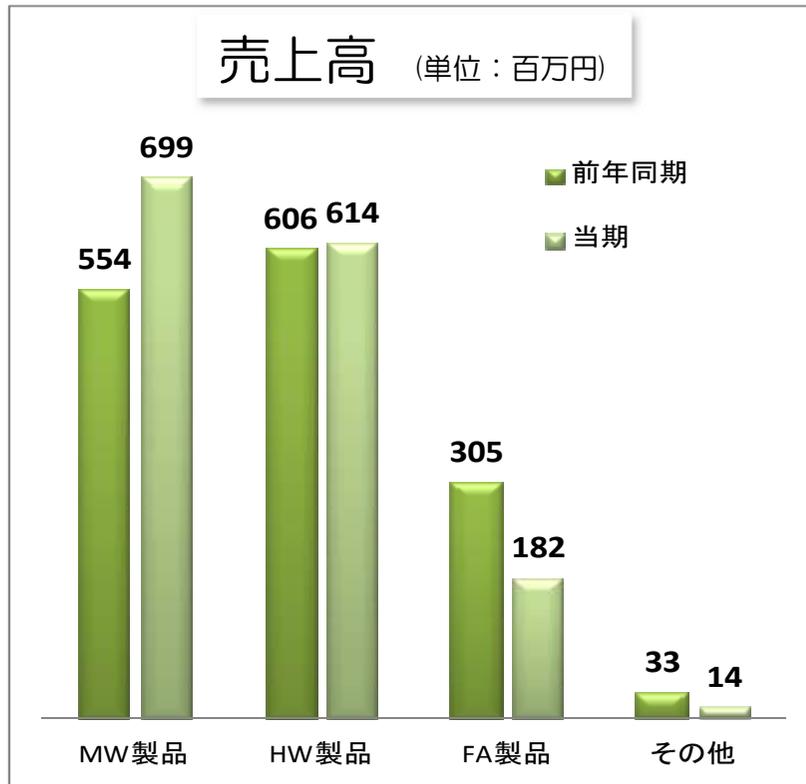


# 営業損益 変動要因

単位：百万円



# セグメント別 前年同期比較



- **ミドルウェア製品事業**  
IPセキュリティ分野や車載分野におけるビジネスが堅調に推移し、売上増加(前年同期比¥145M増(26%増))したものの、一部開発業務の大幅遅延に伴う原価増が影響し、利益面は悪化。
- **ハードウェア製品事業**  
一部不採算事業の見直しに伴い、売上高は横ばい(前年同期比¥7M増(1%増))であったが、LSI開発向け IPなどの自社製品の販売比率が高まり、利益率が改善。
- **FA製品事業**  
FAネットワーク向け製品の大口顧客の需要低下の影響を受け、売上高大幅減少(前年同期比¥123M減(40%減))。

# 中期計画の実現に向けて

---

# 経営方針・ビジョン

**製品販売を主体とした  
収益力の高いビジネスモデルによる、  
強固な経営基盤の確立**

**組込コア技術のリーディング・カンパニー**

~ Embedded Value-sourcing ~

**付加価値が高くユニークなコア技術を持ち、  
ロイヤルティ/量産供給ビジネスを確立し、  
お客様の事業パートナーとなる。**

# 中期 業績計画

- 売上高 20億円
- 営業利益率 10%以上 (売上総利益率50%以上)
- 製品関連の売上比率 70% 以上
- ストック売上比率 50% 以上

	2012年度		2013年度		2014年度	
		前年比		前年比		前年比
売上高	1,509	101%	1,600	106%	1,900	118%
営業利益	▲47	▲72	50	+97	190	+140
営業利益率	-		3.1%		10.0%	

2011年度作成の中期計画に対し、2012年度においてハードウェア製品事業の一部不採算事業からの撤退を決めたため、2014年度までの事業計画を修正。

# 事業セグメント

## ミドルウェア製品事業

- ミドルウェア製品を開発し、ライセンス及びロイヤルティビジネスを展開。
- 既存製品(KASAGO / ONVIF / Mirror Link)の拡販に注力。
- EMS, スマートフォンアクセサリなどの新市場向け製品開発を推進。

## ハードウェア製品事業

- MWと連携したLSI用 IPを開発し、ライセンス及びロイヤルティビジネスを展開。
- MWと連携したモジュール製品を開発し、量産供給ビジネスを展開。
- FPGA設計者などの新しいターゲット市場の開拓を推進。

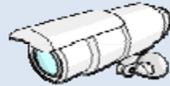
## FA製品事業

- FA分野向けにSW/HW製品を開発し、ライセンス及び量産供給ビジネスを展開。
- Ethernet方式のFAネットワークなどの新市場向け製品開発を推進。

# ターゲット市場

## IPセキュリティ分野

IPセキュリティ機器向けに  
ミドルウェアパッケージや  
モジュール製品を提供



## 車載・AV分野



車載機器やAV機器向けに  
ミドルウェアパッケージを提供



情報  
ネットワーク  
社会

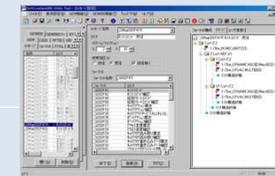
## EMS・汎用分野

エネルギーマネージメントや  
各種機器のネットワーク接続向けに  
ミドルウェアパッケージや  
LSI開発用 IPを提供



## FA・産業分野

産業機器やFAネットワーク向けに  
モジュール製品やソフトウェア  
パッケージを提供



# 2014年 3月期 業績見通し

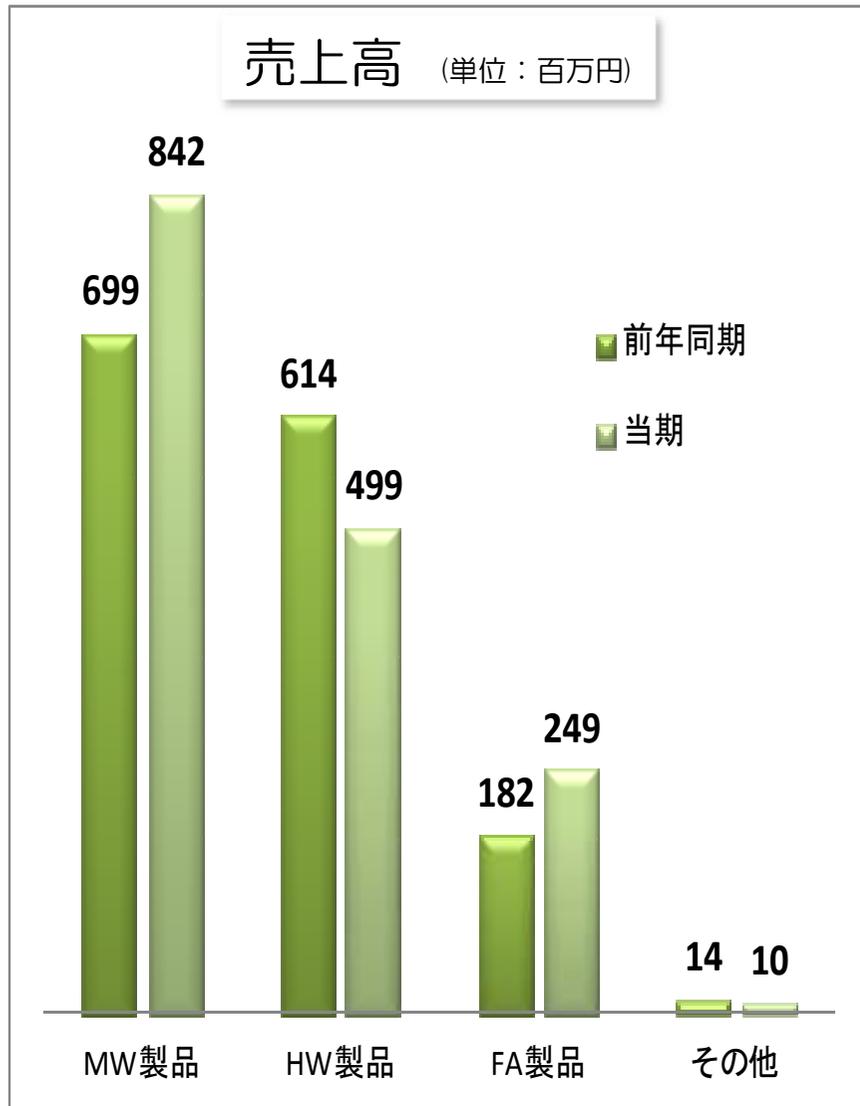
---

# 2014年 3月期 業績見通し

37期 単位：百万円, %	第2四半期 累計		通期	
	見込	前年 同期比	見込	前年 同期比
売上高	690	100%	1,600	106%
売上原価	377	93%	869	92%
売上総利益	312	109%	730	128%
営業利益	0	+35	50	+97
経常利益	0	+34	50	+96
当期純利益	0	+33	40	+163

- 製品販売への一層の注力による売上総利益率の向上
- 開発マネージメント強化による開発遅延・原価増加の抑制
- 外注費・材料費等の厳格管理による売上原価率の低減
- 新製品リリースによる国内外ターゲット市場での業績拡大

# セグメント別 売上高 前年同期比較



## ミドルウェア製品事業

既存のONVIF, Mirror Link向けミドルウェアの機能追加や新製品リリースに加え、エネルギー管理分野向けにECHONET Lite 対応ミドルウェアをリリースし、業績を拡大。

## ハードウェア製品事業

一部不採算事業の撤退に伴い、売上高は減少する見通しだが、LSI開発向けIPのYAMAME製品の拡充ならびにIPセキュリティ分野向けに新しいモジュール製品を投入し、利益率の高い事業を拡大。

## FA製品事業

半導体製造装置・液晶製造装置分野で豊富な実績のある、SEMI規格に対応した既存製品を別分野向けに横展開。  
またFAネットワーク分野にて、新製品開発に取組み業績を拡大。

# 重点拡販製品

## 1. ONVIFライブラリ (IPセキュリティ分野)

- IPセキュリティ機器向け標準IF規格であるONVIF準拠のライブラリ。
- 新規格であるProfile-Sおよび新バージョン対応製品リリースによる業績拡大。
- VMS(Video Management System)向けやスマートフォン向けなどの新製品開発による更なる顧客層の拡大。



国研エルミックは ONVIFのメンバーです



## 2. Mirror Linkライブラリ (車載分野)

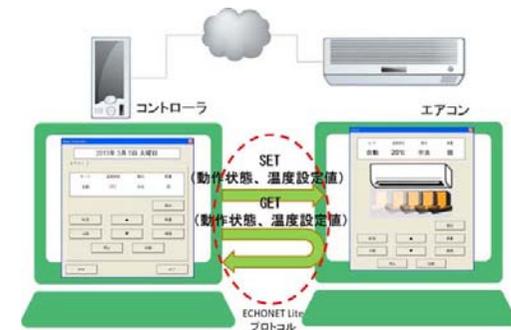
- 車載ディスプレイ機器とスマートフォンを双方向でつなぐ通信規格であるMirror Link準拠のライブラリ。
- 追加機能を拡充した新製品リリースによる顧客層の拡大。
- 無線通信対応など、パートナー各社と連携してソリューションを拡大し、顧客層を拡大。



# 重点拡販製品

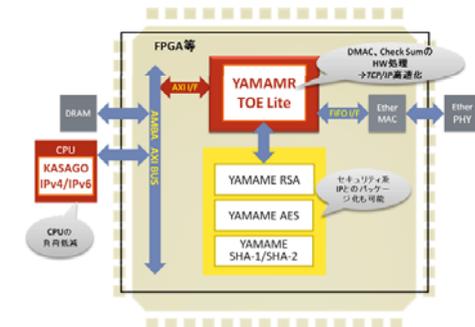
## 3. ECHONET Lite (EMS分野)

- 家電や設備機器を接続してホームネットワークを実現する通信規格ECHONET Liteを実現するミドルウェア。
- HEMSやMEMSなどエネルギーマネージメント関連製品を開発する顧客層へビジネスを拡大。
- 実績の豊富なTCP/IPミドルウェア(KASAGO)との組み合わせやパートナー各社との協調により効率のよい開発を提案。



## 4. YAMAME TOE Lite/RTP/UDP (汎用分野)

- 実績の豊富なTCP/IPミドルウェア(KASAGO)をハードウェア化したLSI開発向け IP群。
- ソフトウェア処理では負荷の大きい機能をハードウェア化することで、通信の安定性と高速性を実現。
- デジタル放送機器などの製品向けに提案を拡大。
- FPGA設計者など新たな市場を拡大。



- ご注意 -

本プレゼンテーション資料および図研エルミック代表者が口頭にて提供する情報には、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されています。

# 会社紹介

---

(参考資料)

# 会社概要

社名	図研エルミック株式会社	
設立	1977年4月30日	
資本金	1,202,036,093円 (2013年3月31日現在)	
事業内容	ミドルウェア製品及びシステム・モジュール製品の開発ならびに販売	
従業員数	82名 (2013年3月31日現在)	
事業所	本社 (横浜市港北区新横浜3-1-1 図研新横浜ビル) 大阪営業所 (大阪市浪速区湊町1-4-38号 近鉄新難波ビル9階)	
役員	代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 監査役(常勤) 監査役 監査役	勝部 迅也 朝倉 尉 下条 雅人 大門 肇 安藤 貴三男 新井 浩之
加盟団体	一般社団法人 組込システム技術協会 IPv6 Ready Logo Program SEMI UPnP Forum ONVIF CAR CONNECTIVITY consortium T-Engine Forum	      

# 沿革



- 1977 •(株)エルミックシステムを横浜市に設立
- 1983 •ELXシリーズ(ELX-86M)販売開始
- 1998 •組込み専用インターネットプロトコル(KASAGO TCP/IP)販売開始
- 2000 •東証マザーズ上場(7月25日)  
•半導体製造装置向け通信ソフトウェア(SoftCom)販売開始
- 2002 •KASAGO IPv6販売開始
- 2003 •国内初IPv6 Ready Logo取得
- 2004 •半導体製造装置向け通信ソフトウェア(GEM300)販売開始
- 2005 •ウェスコム社と合併し、エルミック・ウェスコム株式会社に  
•IPv6 Ready Logo Phase-2取得
- 2006 •IPSec販売開始
- 2007 •SIP販売開始  
•(株)シーイーシーと業務資本提携

- 2008 •(株)図研と業務資本的提携
- 2009 •(株)図研よりSoC事業部を分割吸収(6月)  
•社名を図研エルミック株式会社に(7月)
- 2009 •IPセキュリティ向けミドルウェア(Ze-PRO RTP, ONVIF)販売開始  
•セキュリティアダプター(IP-Cipher)販売開始
- 2010 •オプテックス社とセンサーソリューションで業務提携  
•PC98アーキテクチャ互換システム(iNHERITOR II)販売開始
- 2011 •ONVIF NVS部ライブラリ(Ze-PRO IPrec)販売開始  
•LSI開発向けIP(YAMAME JPEG-XR)販売開始  
•IPSec / IKEv2販売開始
- 2012 •Ze-PRO IPrecが日刊工業新聞 十大新製品賞 中堅・中小企業賞を獲得  
•菱洋エレクトロ殿, 東芝情報システム殿, コア殿と販売・サポート提携開始  
•ジーニック殿(Forte Vision), モルフォ殿(画像処理SW)の代理店開始
- 2012 •LSI向けIP(YAMAME TOE Lite / RSA / AES / SHA-1/2)販売開始  
•SS無線LANモデム(Ze-Module WLAN)販売開始
- 2012 •Mirror Link対応ミドルウェア(Ze-PRO Mirror)販売開始  
•ONVIF Profile-S対応ミドルウェア(Ze-PRO IPcam-PS, IPmon-PS)販売開始
- 2013 •ECHONET Lite対応ミドルウェア販売開始  
•LSI開発向けIP(YAMAME UDP/RTP)販売開始

# 事業概要

“つなぐ・ながす” 先端ネットワーク技術を「素材」に変えて提供します。

## ミドルウェア 製品事業

各種規格に適合したコア技術を、各アプリケーションに最適化した、ミドルウェアパッケージとしてご提供します。



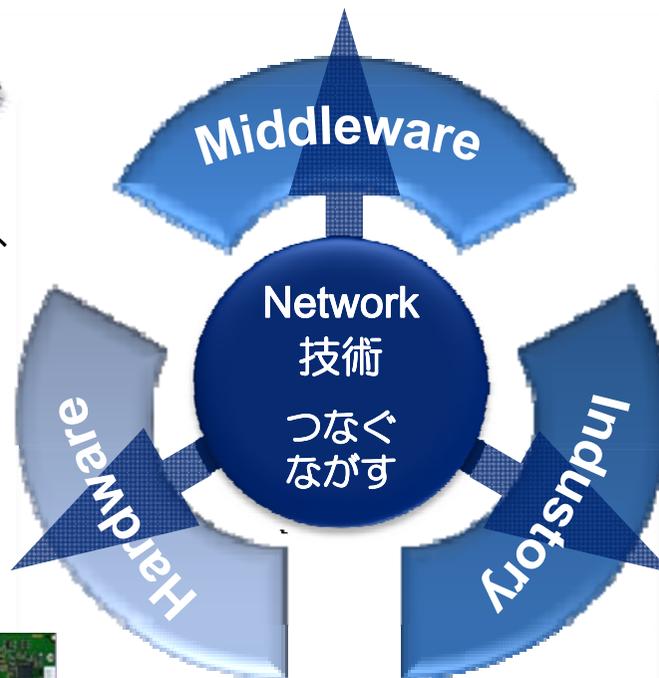
- ・TCP/IP(KASAGOシリーズ) ・Mirror Link(Ze-PROシリーズ) ・ONVIF(Ze-PROシリーズ) ・ECHONET Lite ...

## ハードウェア 製品事業



ミドルウェアで培ったコア技術を、LSI開発・システム開発向けのハードウェア製品としてご提供します。

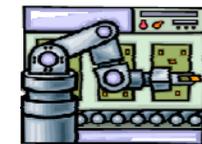
- ・LSI/FPGA開発向けIP (YAMAMEシリーズ)
- ・システム開発向けモジュール (Ze-Moduleシリーズ)

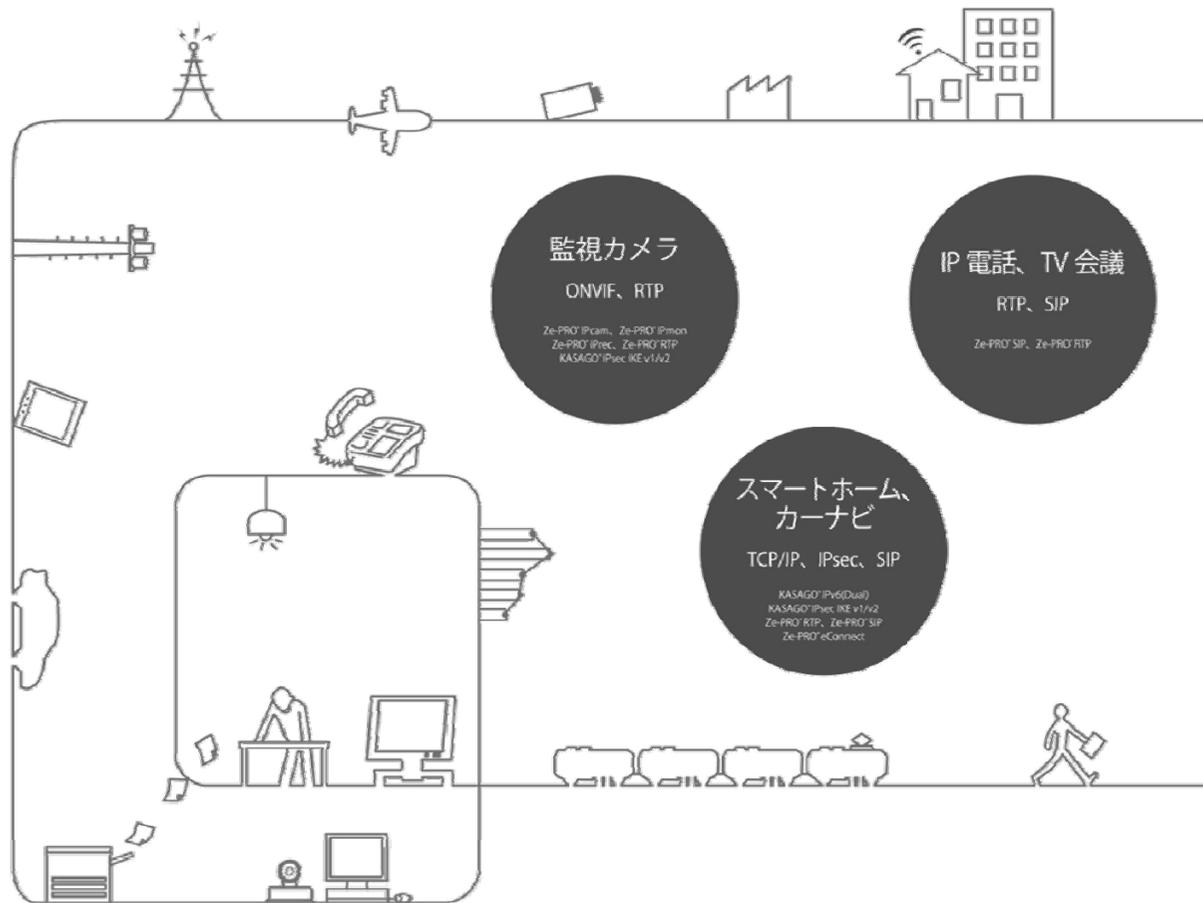


## FA 製品事業

ミドルウェアで培ったコア技術を、産業機器向けのSW製品・HW製品としてご提供します。

- ・レガシー機器向け (iHERITOR II / II-A) (各種通信ボード)
- ・FAネットワーク向け (SoftCom)





## 図研エルミック株式会社

Tel : 0120-045-690

URL : <http://www.elwsc.co.jp/>

Email : [info@elwsc.co.jp](mailto:info@elwsc.co.jp)